



株式会社 新川
ニュースリリース

2018年10月22日

新型ワイヤボンダ UTC-5000Super・UTC-5000NeoCu Super 受注開始

株式会社新川（社長：長野高志、東京都新宿区）は、主力製品であるワイヤボンダ UTC-5000 シリーズのアップグレード機種として、「UTC-5000Super/UTC-5000NeoCu Super」を開発し、受注を開始しました。

<『UTC-5000Super/UTC-5000NeoCu Super』の特長>

新機能 SimLoop 標準搭載の高速ワイヤボンダ

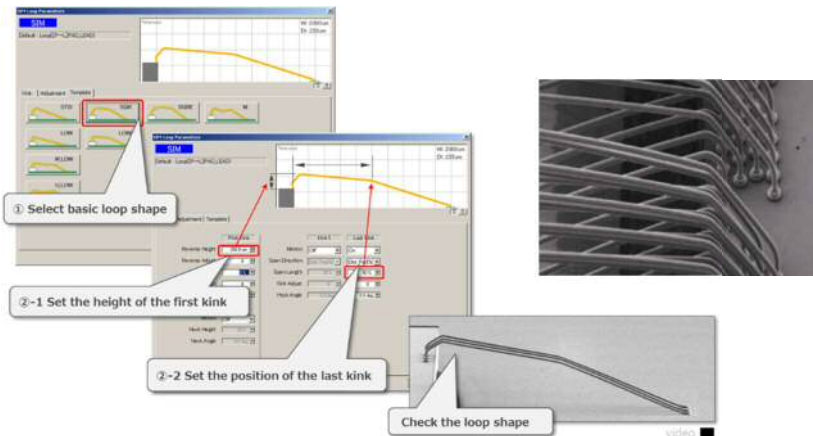
- ・ 新設計ループシェーピングエンジン搭載でループ形状の自動最適化
- ・ ループディスプレイ機能搭載、直感的なループ形状調整が可能
- ・ ループテンプレートによる条件出し時間の大幅削減を実現
- ・ オーバードライブ機能を搭載し UPH 約 7%向上を実現 (*)

理想ループ実現への 2 ステップ

Step1 作りたいループ形状（テンプレート）を選択

Step2 ループの基本寸法設定

新川ループシェーピングエンジンが、設定されたパラメーターを自動的に最適化し、ループを形成、調整時間の大幅削減を実現。



*デバイス条件による

従来機種(UTC-5000、UTC-5000NeoCu)にSimLoop機能を追加する「SimLoopキット」も同時に販売開始します。
なお、2018年12月12日から14日に開催のSEMICON Japan 2018において「UTC-5000NeoCu Super」の実機を展示する予定です。皆様のご来場をお待ちしております。

SEMICON Japan 2018（会場:東京ビックサイト） ブースNo.1206

■ その他当社取扱製品

ダイボンダ、バンプボンダ、フリップチップボンダ等

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：マーケティング営業本部 北林 靖基・田島 寛敏（TEL：03-5937-6401）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：03-5937-6404）

株式会社 新川

〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー32階